

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“中微公司”）拟在成都市高新区投资设立全资子公司中微半导体设备（成都）有限公司（以下简称“项目公司”，具体名称以届时市场监督管理部门核准为准），建设研发及生产基地暨西南总部项目。
- 2025年至2030年期间，项目总投资约30.5亿元。项目公司注册资本为1亿元人民币。
- 本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组。
- 相关风险提示：
 - 1、技术风险，项目公司核心技术研发难度大，可能导致研发进度延迟。
 - 2、市场风险，半导体市场需求波动或竞争加剧，可能影响销售目标的实现。
 - 3、政策风险，政策变化可能对项目公司的土地供给及支持等政策产生不利影响。
 - 4、管理风险，项目规模较大，需有效协调各方资源，确保按时完成建设和投产。

公司将强化技术团队建设，加强市场调研，保持与政府部门的密切沟通，并优化项目管理流程，降低潜在风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟在成都市高新区投资设立全资子公司中微半导体设备（成都）有限公司（具体名称以届时市场监督管理部门核准为准），建设研发及生产基地暨西南总部项目。项目的实施将有助于公司扩展集成电路设备业务范围，增强技术研发能力，提升市场占有率。

2025年至2030年期间，项目总投资约30.5亿元。项目公司注册资本为1亿元人民币。

（二）对外投资的决策与审批程序

本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司的基本情况

公司名称：中微半导体设备（成都）有限公司

法定代表人：尹志尧

成立时间：2025年2月

注册资本：1亿元人民币

资金来源：中微公司自有资金

出资比例：中微公司持有项目公司100%股权

注册地址：成都市郫都区合顺路2号IC设计产业园2栋2单元609

经营范围：研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及其环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品，提供技术咨询、技术服务。

项目公司的情况以届时市场监督管理部门核准为准。

（二）投资项目具体情况

项目公司将在高新区建设研发中心、生产制造基地、办公用房及附属配套设施，配备先进的自动化生产线和高精度检测设备，满足量产需求。项目公司将积极推动公司上下游供应链企业落户成都高新区，推动形成半导体高端装备产业链集群。

项目公司将面向高端逻辑及存储芯片，开展化学气相沉积设备、原子层沉积设备及其他关键设备的研发和生产工作。项目公司将在设立后，加强与成都高校和科研院所等的合作，通过联合研发、创新人才培养等形式，推动产学研一体化，提升区域科技创新能力。

（三）投资项目用地及建设规模

项目公司用地约 50 亩，建设包含研发中心、生产基地和配套设施。

（四）投资项目预计经济效益

项目公司预计到 2030 年年销售额达到 10 亿元，助力区域性半导体产业链的升级。

三、与政府签订的投资协议的主要内容

为项目公司成功落地，中微公司将与成都高新技术产业开发区管理委员会签订有关投资落地的投资协议。成都高新技术产业开发区管理委员会，致力于为入驻企业提供政策支持和基础设施保障。

投资协议主要内容如下：

1、总投资额

项目总投资约 30.5 亿元。

2、土地使用

项目用地约 50 亩，土地使用年限 50 年。

3、项目进度

项目计划于 2025 年开工，2027 年投入生产。

四、对外投资对上市公司的影响

通过设立项目公司，增强研发能力和扩大产能，公司将在高端半导体设备领域进一步巩固优势地位。项目建成后，将提升公司的整体营业收入，对上市公司业绩增长形成有力支撑。

五、对外投资的风险分析

1、技术风险，项目公司核心技术研发难度大，可能导致研发进度延迟。

2、市场风险，半导体市场需求波动或竞争加剧，可能影响销售目标的实现。

3、政策风险，政策变化可能对项目公司的土地供给及支持等政策产生不利影响。

4、管理风险，项目规模较大，需有效协调各方资源，确保按时完成建设和投产。

公司将强化技术团队建设，加强市场调研，保持与政府部门的密切沟通，并优化项目管理流程，降低潜在风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年1月15日